



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120210005
2012 年 2 月 15 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

PWR RSLパッケージ 一部製品 組立検査サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	☒ Test	☒ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	PWR RSL パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加 現行 : TI-Malaysia(マレーシア) 変更後: TI-Malaysia(マレーシア), TI-Clark(フィリピン)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	5月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：弊社 PWR(パワーマネジメント) RSLパッケージ 一部製品の組立検査サイトについて、現行 TI-Malaysia(マレーシア)サイトにて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Clark(フィリピン)サイトを追加します。組立部材の変更については下記の通りです。TI-ClarkサイトにおけるQFNパッケージ製品の製造は認定されています。下記信頼性試験結果(2009年9月9日終了)を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
組立検査サイト	TI-Malaysia(マレーシア)	TI-Malaysia(マレーシア) TI-Clark(フィリピン)

組立サイト		チップ接着剤
現行	TI-Malaysia	4205846
追加認定	TI-CLARK	4207768

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
SN1010007RSLR	TPS650702RSLR	TPS65071RSLR	TPS65072RSLR	TPS650732RSLR
SN1010007RSLT	TPS650702RSLT	TPS65071RSLT	TPS65072RSLT	TPS650732RSLT
TPS650701RSLR	TPS65070RSLR	TPS650721RSLR	TPS650731RSLR	TPS65073RSLR
TPS650701RSLT	TPS65070RSLT	TPS650721RSLT	TPS650731RSLT	TPS65073RSLT

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び製品捺印が下記のようになります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	TI-Malaysia	MLA
追加認定	TI-Clark	QAB



図1 出荷ラベルの例

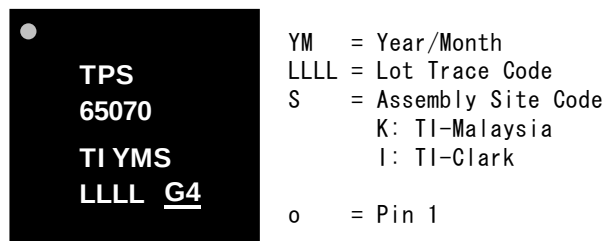


図2 製品捺印の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	MSC1202Y3RHHR	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RHH/36	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 1.0 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		82/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2009年9月9日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ONET4291VARGPR	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RGP/20	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 0.96 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp Operating Life	140C, 480 hours		116/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		82/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Backgrind Characterization	-		Approved	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SH6966ACC0RGCRG4_AU WIRE			
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RGC/64	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 1.15 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp Operating Life	125C, 1000 Hrs		140/0	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		81/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Solderability	Steam age, 8 hours		22/0	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Salt Atmosphere	24 Hrs		22/0	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C		22/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009年9月9日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SH6966ACC0RGCRG4_CU_WIRE			
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RGC/64	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Cu, 1.15 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp Operating Life	125C, 1000 Hrs	140/0	140/0	141/0
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	87/0	82/0	87/0
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ	Approved	Approved	Approved
Solderability	Steam age, 8 hours	22/0	22/0	22/0
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5/0	5/0	5/0
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Salt Atmosphere	24 Hrs	22/0	22/0	22/0
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	22/0	22/0	22/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	SN65LVCP40RGZ		-	-
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RGZ/48	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 0.96 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp Operating Life	155C, 240Hrs		116/0	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		82/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPA5050RSA	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RSA/16	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 0.96 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp Operating Life	140C, 480 hrs		116/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		80/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2231RGPR_AU_WIRE	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RGP/20	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 2.0 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp Operating Life	155C, 240 Hrs		77/0	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		87/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Solderability	Steam age, 8 hours		22/0	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Salt Atmosphere	24 Hrs		22/0	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	TPS2231RGPR_CU_WIRE		-	-	
Assembly Site:	TI Clark		Package/Code/Pins:	QFN/RGP/20	
Mount Compound:	4207768		Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Cu, 2.0 Mil Diameter		Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C		-	-	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
**High Temp Operating Life	155C, 240 Hrs	77/0	77/0	77/0	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	87/0	87/0	87/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ	Approved	Approved	Approved	
Solderability	Steam age, 8 hours	22/0	22/0	22/0	
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5/0	5/0	5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0	
Die Shear	-	10/0	10/0	10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0	
Salt Atmosphere	24 Hrs	22/0	22/0	22/0	
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12/0	12/0	12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C					

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS61020DRC_AU_WIRE	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/DRC/10	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 0.95 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		87/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS61020DRC CU WIRE	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/DRC/10	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Cu, 0.95 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	87/0	87/0	87/0
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ	Approved	Approved	Approved
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5/0	5/0	5/0
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS62402DRCR_AU_WIRE	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/DRC/10	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 1.3 mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		87/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Salt Atmosphere	24 Hrs		22/0	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS62402DRCR_CU_WIRE	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/DRC/10	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Cu, 1.3 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		87/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Salt Atmosphere	24 Hrs		22/0	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS650240RHBR_AU_WIRE	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RHB/32	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Au, 1.3 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		87/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
X-ray	top side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 9 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS650240RHBR_CU_WIRE	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RHB/32	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	Cu, 1.3 Mil Diameter	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		87/0	
Visual / Mechanical	Performed during Assembly MQ		Approved	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Pull	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Bond Shear	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability, Assembly	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
X-ray	top side only		5/0	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				